证券代码：688693　　证券简称：锴威特　　公告编号：2026-050

苏州锴威特半导体股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 8 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长丁国华先生召集并主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于本次交易加期相关的审计报告、模拟审计报告和备考审阅报告的议案》

经审议，公司董事会认为：同意将本次交易加期相关的审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶艺半导体有限公司审计报告》《晶艺半导体有限公司模拟审计报告》《苏州锴威特半导体股份有限公司审阅报告》。

（二）审议通过了《关于<苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：同意公司对《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要进行修订及更新，形成《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要，并将根据证券监管机构的审核意见进行相应补充、修订（如需）。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》和《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）之摘要》。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日